

参加無料 オンライン開催

半導体製造 加工最前線解説

開催日時

前編：2025.09.25 13:30~15:00

後編：2025.09.30 13:30~15:00



碌々スマートテクノロジー 岩田様



ユニオンツール 星様



岡本工作機械製作所 小田様



メトロール 篠澤様



山本金属製作所 松田様

国内外の半導体製造工程における加工の最前線で導入されている工作機械、切削工具、周辺機器メーカー様にご登壇いただき、最新のトレンドや事例をご紹介します。

前編

微細・小径穴明け加工ニーズからみる半導体市場動向解説

- ・半導体業界の市場動向解説
- ・脆性材加工における微細、細穴加工技術トレンド、半導体にける最新工具紹介

講師：碌々スマートテクノロジー株式会社 取締役 営業本部長 岩田様
ユニオンツール株式会社 第一工具技術部長 星様

後編

最新脆性材研削加工の省力化、品質安定のススメ

- ・半導体製造における最新脆性材研削加工事例と加工機紹介
講師：株式会社岡本工作機械製作所 北関東営業所 小田様
- ・「国内製」機上計測機を用いた自動化提案と半導体製造装置向けセンサー紹介
講師：株式会社メトロール 営業部長 篠澤様
- ・機械加工におけるクーラント監視による品質安定提案と導入事例紹介
講師：株式会社山本金属製作所 営業部 営業企画G 課長 松田様

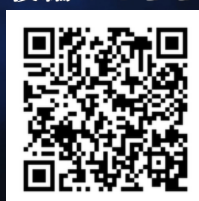
お申込み

- ・下記のQRコードもしくは、「ものづくり研究所」のホームページよりお申込みください。
- ・使用ウェビナーツール：zoom ※PC、スマホ、どちらからでも視聴可能です。

前編はこちら



後編はこちら



主催：ものづくり研究所